

奇景光電推出領先業界的 TDDI 「HiSIT™」觸控晶片解決方案

準備第四季量產出貨 未來將持續成長動能

【台南，2015 年 8 月 18 日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）推出領先業界的 TDDI 「HiSIT™」單晶片（觸控與顯示面板整合型單晶片），目前正與多家領先的面板廠及手機廠緊密合作開發 full in-cell 的技術，應用在智慧型手機及平板電腦。奇景的觸控晶片，除了既有的 out-cell、on-cell 解決方案已量產出貨，預計在今年第四季，奇景 TDDI 「HiSIT™」單晶片亦將開始量產出貨。

奇景 TDDI 「HiSIT™」單晶片，可降低面板廠的系統成本，亦能夠大幅簡化手機廠供應鏈結構，增加採購便利性。在手機廠追求強大效能的趨勢下，此 TDDI 「HiSIT™」單晶片解決方案仍然能夠提供更薄、更輕及更時尚的設計。在智慧型手機及平板電腦方面，業界正在尋求具有成本效益、創新顯示及觸控的解決方案。奇景將 LCD 驅動 IC 及觸控 IC 整合成高度複雜的 TDDI 「HiSIT™」單晶片，符合業界期待，是目前最先進的 full in-cell 觸控解決方案，可支援 HD 解析度的智慧型手機及 WXGA 解析度的平板電腦。

奇景光電執行長吳炳昌表示，TFT-LCD 的一線面板廠，正驅動產業朝 full in-cell 面板、尋求高附加價值及創新的技術方向發展，而奇景正是提供整合複雜度高的 TDDI 單晶片技術領先者之一。奇景很高興獲得多家頂級客戶的開發新案，證明奇景在最新 full in-cell 技術的領先及優勢地位。目前正與多家領先的面板廠緊密合作開發 TDDI 解決方案的技術，預計在今年第四季，奇景 TDDI 「HiSIT™」單晶片將開始量產出貨，並對 2016 年營收及獲利產生顯著貢獻。

總結來說，奇景光電相信，此 TDDI 「HiSIT™」單晶片是目前業界針對觸控面板的最佳解決方案，滿足面板廠降低成本及簡化供應鏈的需求，即將成為智慧型手機及平板電腦的應用主流。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與頭戴式矽控液晶光閥(LCOS)微型投影解決方案、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括 CMOS 影像感測 IC 及晶圓級鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全及醫療器材等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約 1,800 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至 2015 年 6 月 30 日為止，奇景光電在全球已取得 2,650 項專利，尚有 648 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
媒體關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

陳荻雅 / Nadiya Chen
投資人關係 經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
nadiya_chen@himax.com.tw

林佳慧 / Penny Lin
投資人關係 經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22320
penny_lin@himax.com.tw

Investor Relations- US Representative
Adam Holdsworth, Managing Director
PCG Advisory Group, LLC
+1-646-862-4607
adamh@pcgadvisory.com
www.pcgadvisory.com

風險說明:

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2014 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。